

中国电子学会

关于召开第十二届印制电路与封装 学术年会的通知

各有关代表：

在电子信息产业智能化加速发展的新形势下，为了进一步推动我国电子制造与封装技术的创新与发展，加强技术创新与产业创新相融合，促进学术界与产业界的交流与合作，中国电子学会定于2026年11月8日—10日在安徽广德举办第十二届印制电路与封装学术年会，大会主题为“乘智而上·以质致远”。会议围绕当前印制电路、电子电镀、先进封装、电子装联与微组装等领域的热点问题和前沿技术，展示最新的科研成果和先进技术应用案例，为科技工作者提供一个全面了解行业动态、拓宽学术视野、促进产学研合作的平台，推动我国电子制造与封装技术进步和行业健康可持续发展。

大会拟通过特邀报告、大会报告、专题报告、新技术新产品推介等50余场报告交流活动，集中展示印制电路与封装行业内最新研发成果与解决方案。

现诚挚邀请电子制造与封装领域的各界代表共同参与本次会议！

一、会议时间

2026 年 11 月 8 日—10 日（8 日报到）

二、会议地点

安徽省广德市广德开元名都酒店

三、报告主题

T1 行业综述与政策标准法规：印制电路制造、电子电镀、先进封装、焊接与微组装等领域发展趋势和动态综述、行业市场分析、标准及环保安全清洁生产等

T2 设计：印制电路和先进封装设计、建模与仿真技术

T3 新材料：印制电路、电子电镀、先进封装、焊接与微组装等领域新材料

T4 新工艺：印制电路、电子电镀、先进封装、焊接与微组装等领域新工艺

T5 新产品：新型印制电路、新型电子化学品、先进封装与微组装产品等

T6 质量和检测：印制电路、电子电镀、先进封装、焊接与微组装等领域质量控制与测试、可靠性评估、寿命预测、失效分析、无损检测等

T7 智能制造：相关领域智能化工厂规划和建设、智能生产管理、智能制造与测试设备及应用等

四、组织架构（拟）

主办单位：中国电子学会电子制造与封装技术分会

承办单位：广德电子电路行业协会、安徽绿洲危险废弃物综合利用有限公司、广东省电子电路行业协会

大会主席：

陈长生 中国电子学会理事、电子制造与封装技术分会主任委员

大会程序委员会:

主 席: 陈长生

副主席: 朱民、曾红、蔡坚、潘丽、曾耀德

大会组织委员会:

主 席: 袁胜巧

副主席: 高宏、沈剑详、项百春、胡国辉

秘书长: 郭晓宇

秘 书: 杨涵、汪继芳、钱杭、黄欣

五、注册费用说明

(一) 注册费用

门票类型	10月8日 之前	10月8日— 11月8日	11月8日— 10日
非会员	650 元/人	700 元/人	800 元/人
会员	600 元/人	650 元/人	700 元/人
学生会员	500 元/人		

参会权限:

1. 大会期间所有学术活动(内部会议除外);
2. 大会组委会提供的会议资料;
3. 大会组委会提供的8日和9日晚餐、9日和10日午餐。

(二) 交费方式

1. 支付方式支持线上支付(支付宝、微信)和银行转账。

2. 选择银行转账支付方式的报名之后汇款至如下账户：

户名	中国电子学会
开户银行	中国工商银行北京公主坟支行
银行账号	9558850200000574819
备注	制造+姓名+单位名称（单位对公转账不用备注单位名称）

选择银行转账支付方式的请务必在报名系统中上传缴费凭证，通过审核后视为报名成功；

本次会议注册费不支持现场刷卡，请将公务卡绑定微信或支付宝，使用线上支付方式支付；

报名成功后，您将收到一条确认短信，内有二维码链接，用于现场签到，如未收到可检查是否被拦截或联系会务组，现场报手机号和姓名也可签到。

（三）其他说明

会议费报销所需的盖章件通知，可在大会官网自行下载，会议食宿统一安排，费用自理；

线上支付的会议发票会后请自行登录报名系统实时开出，务必准确填写开票信息；

银行转账的会议发票会后 15 个工作日内开出并发送至报名时的手机和邮箱；

线上支付的因不可抗力需要办理退费，请于 11 月 9 日前自行登录报名系统点击退款，费用实时原路退回，银行转账的请提前单独联系会务组，11 月 11 日起系统将无法退费，

组委会不再处理退费申请。

六、联系人

会议合作及注册:

郭老师 13651018761, pcbagxy@163.com

附件：第十二届印制电路与封装学术年会议程（拟定）



附件：

第十二届印制电路与封装学术年会 议程（拟定）

第十二届印制电路与封装学术年会				
11月8日（星期日）				
时间	内容		地点	
13:00-20:00	报到		一层大堂	
11月9日（星期一）上午				
时间	会议安排	内容	主持人	地点
8:00-9:00	嘉宾签到			三层会议厅
9:00-9:20	嘉宾致辞	中国电子学会领导 安徽省广德市领导	分会领导	三层会议厅
9:20-9:40	特邀报告	清华大学		
9:40-10:10	特邀报告	生益科技		
10:10-10:25	技术交流	1篇 J1		
10:25-11:10	大会报告	3篇 D1-D3		
11:10-12:00	专题报告	5篇 Z1-Z5		
12:00-13:30	午餐			
11月9日（星期一）下午				
13:30-13:50	特邀报告	广合科技	分会领导	三层会议厅
13:50-14:10	特邀报告	安捷利美维	分会领导	三层会议厅
14:10-14:30	特邀报告	广信油墨	分会领导	三层会议厅
14:30-15:00	技术交流	2篇 J2-J3	分会领导	三层会议厅
15:00-15:20	技术交流			三层

15:20-16:20	大会报告	4 篇 D4-D7	分会领导	三层会议厅
16:20-18:00	专题报告	10 篇 Z6-Z15	分会领导	三层会议厅
18:00-19:30	大会晚餐			三层会议厅
11 月 10 日（星期二）上午				
9:00-9:20	特邀报告	江南大学	分会领导	三层会议厅
9:20-9:40	特邀报告	华为	分会领导	三层会议厅
9:40-10:10	技术交流	2 篇 J4-J5	分会领导	三层会议厅
10:10-10:30	技术交流			三层
10:30-11:15	大会报告	3 篇 D8-D10	分会领导	三层会议厅
11:15-12:05	专题报告	5 篇 Z16-Z20	分会领导	三层会议厅
12:05-13:30	午餐			
11 月 10 日（星期二）下午				
13:30-13:50	特邀报告	兴森科技	分会领导	三层会议厅
13:50-14:10	特邀报告	封装基板	分会领导	三层会议厅
14:10-14:40	技术交流	2 篇 J2-J3	分会领导	三层会议厅
14:40-15:00	技术交流			三层
15:00-15:45	大会报告	3 篇 D11-D13	分会领导	三层会议厅
15:45-17:45	专题报告	12 篇 Z21-Z33	分会领导	三层会议厅
17:45-18:00	闭幕	大会闭幕总结	分会领导	三层会议厅